

2020年度 第2回半導体エレクトロニクス部門委員会 第1回研究会

主催：日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会
期 日：2020年8月1日（土） 10：30～17：00（予定）
10:30～11:40：基調講演(30分)+一般講演(口頭講演、質疑応答込1件20分)
13:00～17:00：一般講演(口頭講演、質疑応答込1件20分)
会 場：オンライン開催（主催：大阪大学）
※参加申込を頂いた方に招待状をお送りします
一般参加費：無料

半導体エレクトロニクス関連の材料・デバイス応用に関する研究発表を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

■半導体エレクトロニクス部門委員会の賞

本研究会における優れた発表に対して半導体エレクトロニクス部門委員会から下記の賞を授与します。ただし、事前の応募が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込時に、その旨をご記入ください。

学生優秀講演賞：博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

講演奨励賞：若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

■申込方法

講演を希望される方は、講演申込期日までに半導体エレクトロニクス部門委員会ホームページの「研究会の予定（http://algainn.jsms.jp/?page_id=48）」からお申し込みの上、講演原稿送付期日までに講演原稿を投稿してください。

<講演申込内容>

・講演タイトル、著者名、所属、学生優秀講演賞・講演奨励賞への応募の有無

<講演原稿作成要領>

・A4 サイズ1-4枚以内（図、表、写真を含む）、日本語または英語
・1枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
・pdfファイルにて投稿

■講演申込期日： 7月10日（金）

■講演原稿送付期日： 7月22日（水）

■参加申込期日： 7月31日（金）

※講演の有無に関わらず、参加申込をされた方にweb会議の招待状をお送りします。

■講演プログラム

プログラムは7月中旬に公開予定です。

<基調講演>

株式会社 ダイヘン

取締役 常務執行役員 技術開発本部長 蓑毛 正一郎 様

「パワーデバイスを活用した高周波技術の産業応用」（仮題）

■その他

当日の参加者には予稿電子ファイルの公開を予定しています。是非ご参加ください。

■問合せ先

大阪大学 大学院工学研究科

市川 修平（半導体エレクトロニクス部門、講演プログラムおよび原稿に関する問い合わせ）

E-mail: [ichikawa\[at\]mat.eng.osaka-u.ac.jp](mailto:ichikawa[at]mat.eng.osaka-u.ac.jp)

[a t]は@に置き換えてください。